

Lagerfähigkeit und Weiterverarbeitung von Leiterplatten

Lagerfähigkeit:

Die Lagerfähigkeit wird von der Lötfläche und den Umgebungsbedingungen während der Lagerung bestimmt. Wir empfehlen deshalb die Teile bei Raumtemperatur trocken zu lagern.

Oberfläche	Lagerfähigkeit
HAL	12 Monate
Ch. SN	6 Monate
Ch. NI/AU	12 Monate

Tempern:

Da Leiterplattenmaterial, besonders Polyimid jedoch auch FR 4, bei Transport und Lagerung Feuchtigkeit aufnimmt sollte ein Tempervorgang vor der Weiterverarbeitung erfolgen. Ohne diese Temperaturbehandlung können die Leiterplatten bei allen Lötverfahren beschädigt werden. Eine Delamination kann dann die Folge sein. Deshalb empfehlen wir vor der Weiterverarbeitung folgende Maßnahmen:

Material	Temperempfehlung
FR 4	120 °C / 3 h
Starr-Flex	120 °C / 6 h
Flex	120 °C / 4 h
Polyimid	120 °C / 6 h

Nur Teile tempern, die weiterverarbeitet werden. Durch die Temperaturbelastung des Temperns werden die Lötflächen (Ch. SN, Ch. NI/AU, HAL) unterschiedlich stark gealtert, was sich negativ auf das Lötverhalten auswirken kann, besonders auch bei Mehrfachlötungen. Polyimidhaltige Teile wie Flex und Starr-Flex sind stark hygroskopisch. Deshalb sollten diese Teile nach dem Tempern sofort weiterverarbeitet werden, da diese bei normalen Umgebungsbedingungen wieder Feuchte aufnehmen.